（上接A33版）

截至本招股说明书摘要签署日，公司生产、采购、销售环节均有序、正常开展，日常订单或重大合同的履行不存在障碍。

（二）新冠疫情对发行人持续经营能力不构成重大不利影响

公司经营风格较为稳健，资产流动性较好，具有较强的抗风险能力，并以优良的产品品质、先进的研发技术、定制化生产制造能力奠定了良好的市场地位，与各领域全球知名客户建立了长期、稳定的合作关系，未因新冠疫情影响公司持续经营能力。

2020年，受益于半导体行业复苏，以及公司良好的生产柔性、较强客户粘性、良好的市场地位等有利因素，在保障客户原有订单及时交付的基础上，公司新承接半导体设备领域客户订单增加较多，为公司持续经营能力提供重要保障。

六、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

公司最近一期财务报告审计截止日为2020年12月31日，财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。

公司预计2021年1-3月营业收入约为7,500万元至8,000万元，同比增幅为10.31%至17.66%；预计归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元，同比增幅为6.05%至19.30%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元，同比增幅为8.87%至22.48%。前述业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次发行前公司股本总额为6,000万股，本次拟公开发行股份数量不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本次发行未安排公司股东公开发售的股份。
发行价格	19.81元/股
发行后每股收益	0.86元/股（按经审计2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	22.99倍（每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	6.65元/股（2020年12月31日经审计扣属于母公司股东的所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	9.36元/股（2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.12倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式	本次发行采用网上直接向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行
发行对象	符合资格的在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
定价方式	通过公司与主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格，或采取届时中国证监会认可的其他方式确定发行价格
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本次发行股份不所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：1、发行人股东王彩男、王阳控股人王彩男、陆巧英和王景余（即月乏春雨）及股春雨投资的承诺：a）后发行人股票上市之日起36个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；b）后发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；b）若上述期限发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价应进行相应调整。2、股东王学军、王小刚、陆兴龙、王水男、韩旭鹏和金建新的承诺自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人股票上市前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺a）在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；c）后发行人股票上市之日起6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；d）若上述期限发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价应进行相应调整；e）3名人个会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、约束措施若本人/本企业违背上述股份锁定承诺，本人/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，发行人有权扣留本人/本企业应获得的现金分红，本人/本企业承诺承担发行股份锁定承诺，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门的要求延长股份锁定期。	
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	39,620.00万元
预计募集资金净额	34,959.08万元
发行费用	4,660.92万元，其中，承销及保荐费用2,488.68万元，审计及验资费用893.00万元，律师费用779.00万元，发行手续费及其他60.24万元，用于本次发行的信息披露费450.00万元（注）
拟上市地点	深圳证券交易所

[1]（发行人股东王春雨于2019年3月末更名为王景余，本招股说明书摘要中称其为王景余或王春雨）

注：以上发行费用均不含税。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州华亚智能科技股份有限公司
英文名称	Suzhou Huaya Intelligence Technology Co., Ltd.
注册资本	6,000万元
法定代表人	王彩男
成立日期	1998年12月21日
整体变更日期	2016年11月21日
住 所	苏州相城经济开发区潢川产业园春兴路58号
邮政编码	215413
电 话	0512-66731999
传 真	0512-66731856
互联网网址	http:// www.huaya.net.cn
电子邮箱	hyss@huaya.net.cn
经营范围	研发、生产、销售：精密金属结构件、精密组装件、半导体设备及仪器、轨道交通设备及配套装置，数字化平用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人改制及设立情况

（一）发行人设立方式及简要历史沿革

发行人系由华亚有限整体变更设立的股份公司。

1998年11月8日，王彩男和陆巧英签署《苏州华亚电讯设备有限公司章程》，拟共同设立华亚有限，注册资本为100.00万元。1998年12月21日，吴县市工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为3205862100949的《企业法人营业执照》。

2004年11月29日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由100.00万元变更为680.00万元，其中股东王彩男和陆巧英以其对华亚有限的债权共计338.00万元转增注册资本；股东王彩男和陆巧英以货币资金出资242.00万元。

2006年12月26日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意公司注册资本由680.00万元增加至1,680.00万元，股东王彩男和陆巧英分别以货币资金增资600.00万元和400.00万元。

2013年12月9日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由1,680.00万元增加至8,480.00万元。股东王彩男和陆巧英分别以货币形式实缴出资1,380.00万元和920.00万元，合计实缴2,300.00万元。

2016年4月25日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由8,480.00万元减少至3,980.00万元，股东王彩男和陆巧英分别减少2,700.00万元和1,800.00万元。

2016年8月17日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由3,980.00万元增加至4,378.00万元，本次新增注册资本398.00万元，由春雨欣投资以货币资金形式增资1,791.00万元。

2016年9月28日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意陆巧英将其持有的华亚有限16.90%的股权（对应的出资额为740.00万元）作价4,995.00万元分别转让给王学军、韩旭鹏、金建新、王小刚、陆兴龙和王水男，其中陆巧英将3.43%的股权（对应的出资额为150.00万元）作价1,012.50万元转让给王学军，将3.43%的股权（对应的出资额为150.00万元）作价1,012.50万元转让给韩旭鹏，将2.74%的股权（对应的出资额为120.00万元）作价810.00万元转让给金建新，将2.74%的股权（对应的出资额为120.00万元）作价810.00万元转让给王小刚，将2.28%的股权（对应的出资额为100.00万元）作价675.00万元转让给陆兴龙，将2.28%的股权（对应的出资额为100.00万元）作价675.00万元转让给王水男。

2016年10月12日，华亚有限召开董事会，决议通过同意华亚有限以2016年8月31日作为股份改制基准日整体变更设立为股份有限公司。2016年10月28日，华亚有限召开股东会会议，同意以华亚有限经审计的净资产196,347,624.37元按照1:0.3056折合股份60,000,000元，净资产大于股本部分136,347,624.37元计入资本公积由全体股东共同享有。

（二）发起人及其投入的资产内容

发行人系由华亚有限整体变更设立的股份有限公司，华亚有限以截至2016年8月31日经审计的公司账面净资产196,347,624.37元为基础，按照1:0.3056的比例折合股本60,000,000.00元，其余136,347,624.37元计入资本公积。

发行人成立时，各发起人的持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	王彩男	32,727,272.00	54.55
2	王春雨	9,000,000.00	15.00
3	春雨欣投资	5,454,545.00	9.09
4	陆巧英	2,676,565.00	4.46
5	王学军	2,055,733.00	3.43
6	韩旭鹏	2,055,733.00	3.43
7	王小刚	1,644,587.00	2.74
8	金建新	1,644,587.00	2.74
9	陆兴龙	1,370,489.00	2.28
10	王水男	1,370,489.00	2.28
合 计		60,000,000.00	100.00

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司股本总额为6,000万股。本次拟公开发行股份数量不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。

发行人股东、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见本招股说明书摘要第一节内容。

（二）股东持股数量及比例

1、发起人持股情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司发起人持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	王彩男	32,727,272	54.55
2	王景余	9,000,000	15.00
3	春雨欣投资	5,454,545	9.09
4	陆巧英	2,676,565	4.46
5	王学军	2,055,733	3.43
6	韩旭鹏	2,055,733	3.43
7	王小刚	1,644,587	2.74
8	金建新	1,644,587	2.74
9	陆兴龙	1,370,489	2.28
10	王水男	1,370,489	2.28
合 计		60,000,000	100.00

2、前十名股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	王彩男	32,727,272	54.55
2	王景余	9,000,000	15.00
3	春雨欣投资	5,454,545	9.09
4	陆巧英	2,676,565	4.46
5	王学军	2,055,733	3.43
6	韩旭鹏	2,055,733	3.43
7	王小刚	1,644,587	2.74
8	金建新	1,644,587	2.74
9	陆兴龙	1,370,489	2.28
10	王水男	1,370,489	2.28
合 计		60,000,000	100.00

3、前十名自然人股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例（%）
1	王彩男	32,727,272	54.55
2	王景余	9,000,000	15.00
3	陆巧英	2,676,565	4.46
4	王学军	2,055,733	3.43
5	韩旭鹏	2,055,733	3.43
6	王小刚	1,644,587	2.74
7	金建新	1,644,587	2.74
8	陆兴龙	1,370,489	2.28
9	王水男	1,370,489	2.28
合 计		54,545,455	90.91

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关系

截至本招股说明书摘要签署日，公司各股东间的关联关系如下：

王彩男与陆巧英系夫妻关系，王景余为王彩男与陆巧英之子，王彩男与王水男系兄弟关系；陆巧英与陆兴龙系兄妹关系。王彩男为春雨欣投资的执行事务合伙人、普通合伙人，持有春雨欣投资12.01%的份额；陆巧英为春雨欣投资的有限合伙人，持有春雨欣投资40.00%的份额。

四、公司的业务和技术情况

（一）发行人主营业务、主要产品及用途

1、发行人主营业务情况

公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件产品，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。

公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造服务商。目前，公司业务领域涵盖半导体设备领域结构件业务，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域结构件业务。

2、公司主要产品及其用途

公司产品具有定制化的特点，工艺复杂、精度要求高，且规格众多。报告期内，公司生产的产品规格种类分别为1.73万种、1.61万种和1.85万种，每种规格产品的月产量从几件到上千件不等。

报告期内，公司主要产品具体如下：

产品名称	产品用途及工艺特点	主要客户	应用领域
1、半导体设备领域			
晶圆刻蚀气体输送中心结构件	产品用途：用于半导体晶圆刻蚀控制设备 工艺特点：结构件的框架结构复杂，框架结构为型钢焊接而成，焊缝综口处需打坡口倒焊接槽，焊接成型后需控制孔位尺寸精度，需使用专用焊接夹具保证焊接变形量，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质	超科林、ICHOR	Lam Research晶圆刻蚀控制设备
晶圆 镀洗、沉积 腔制平台结构件	产品用途：用于半导体化学气相淀积设备 工艺特点：结构件采用金属结构件焊接而成，使用氩弧焊技术焊接固定，整体焊接后需控制形位公差，表面进行粉末静电喷涂，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质	超科林、天弘	Lam Research化学气相淀积设备
晶圆 镀洗、沉积 腔化学反应平台结构件	产品用途：用于半导体化学气相淀积设备化学反应平台 工艺特点：结构件采用金属结构件焊接而成，使用氩弧焊技术焊接固定，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质，整体焊接后需控制形位公差，表面进行粉末静电喷涂	超科林	Lam Research化学气相淀积设备
晶圆或膜设备（PECVD）气体输送装置结构件	产品用途：用于半导体晶圆或膜设备（PECVD）气体输送装置 工艺特点：结构件的管材长度＞2500mm，直线度要求＜0.5mm，框架结构复杂，焊接容易变形，焊接是采用组合式万能焊接平台固定，保证相关安装孔位，焊接人员须取得AWS D.1.1焊接资质	超科林	AMAT晶圆或膜（PECVD）设备系列
超高亮度LED和功率器件外延片、芯片薄膜沉积设备零部件	产品用途：用于超高亮度LED外延片、芯片薄膜沉积设备 工艺特点：结构件的表面喷涂需耐用高亮光粉末，对外观和静电涂装环境要求较高	超科林	中微半导体超高亮度LED薄膜沉积设备
晶圆检测设备（AWX）成像检测平台结构件	产品用途：用于晶圆检测设备成像检测平台 工艺特点：结构件采用金属结构件焊接而成，使用氩弧焊技术焊接固定，焊接人员须取得美国AWS D.1.1焊接资质，整体焊接后需控制形位公差，表面进行粉末静电喷涂	捷普	Rudolph晶圆检测设备
全自动锡膏印刷机、点胶机结构件	产品用途：用于全自动锡膏印刷机 工艺特点：平面度要求高，结构件的上下层安装面必须进行二次加工，确保上表面平面度小于0.03mm，上下面平行度小于0.05mm，整体外轮廓度小于1.0mm	依工电子	富士康等代工厂全自动锡膏印刷机
4W-EFEM化学气相淀积设备	产品用途：用于半导体化学气相淀积设备化学反应平台 工艺特点：结构件采用金属结构件焊接而成，使用定制的专用焊接夹具及氩弧焊技术焊接而成；焊接人员需取得美国AWS D.1.1焊接资质，整体焊接后需控制形位公差；需要使用大体积的涂装烟道于粉末静电喷涂；需要使用装配工艺	捷普	Lam Research化学气相淀积设备
2、其他设备领域			
① 断能源及电力设备领域			
六氟化硫气箱结构件	产品用途：主要用于中压断路器开关、广泛应用于中高端配电领域 工艺特点：结构件使用3.0mm SUS304不锈钢板经焊接机器人高精度焊接而成的密闭气箱，泄漏率等级 [illegible]	施耐德	输配电领域的中压断路器开关
高压输变电电气开关柜及内部结构件	产品用途：主要用于高压输变电开关柜及内部结构 但气绝缘开关、气体绝缘开关、隔离开关、罐式断路器等），开关柜产品主要用于户外环境 工艺特点：采用6系铝镁合金板，数控冲床下料，箱体采用铝箱焊接，以及整体铆接而成，镀接处均需涂密封胶，开关柜结构件有IP 65防护等级，对抗腐蚀性能和密封性能要求较高	通用电气	输变电领域的高压电气开关
光伏逆变器箱体结构件	产品用途：主要用于33kW至500kW等功率的光伏逆变器，耐受性好，防尘防水等 工艺特点：结构件的焊接密封性、表面喷涂的抗腐蚀性等要求较高	SMA和爱士惟	光伏逆变器
光伏逆变器散热箱体结构件	产品用途：用于6kW等相光伏逆变器，具有耐受性好，防尘防水、钝化效率高等特点 工艺特点：散热逆变器由散热铝型材及用铜封板焊接而成，需进行静电喷涂，对表面喷涂的抗腐蚀性等方面要求较高	SMA和爱士惟	光伏逆变器
② 通用设备领域			
PCB检测设备结构件	产品用途：用于PCB检测设备，设备通过影像摄取、信息处理和检测，形成缺点报告 工艺特点：采用6系铝合金板配合CNC一次粗加工，再进行热处理去内应力，再进行二次精加工，表面需要阳极氧化处理	康代影像	PCB检测设备
智能办公设备结构件	产品用途：人性化智能调节办公桌面高度，满足办公人员好适性	华佗机械	智能桌椅
X射线光谱测定分析仪结构件	产品用途：用于X射线光谱测定分析仪，分析仪用于检测各种材料的化学成分和结晶结构，主要应用于制药、化工、金属和环境材料等行业 工艺特点：结构件外侧材质为化质厚度铝板结构件，内侧衬有一层1.5mm的铝板，中间用胶水粘接，有防X射线的要求	岛津精密	精密检测仪器
翅片类换热器结构件	产品用途：用于翅片式换热器设备，设备通过传递热流体的部分热量给冷流体，达到换热的效果 工艺特点：采用6系铝镁合金板数冲下料，风机安装板采用油压机拉伸成型，翅体子件采用铆接焊接，表面进行喷粉处理。	德默菲亚	翅片式换热器
液晶面板清洗线	产品用途：直接用于0.5张米厚的TFT-LCD面板胚片及微粒清洗 工艺特点：全日动传送控制系统，槽体的材料为PVC，用热风给加热焊条焊接结合粘结而成，焊接密严格控制材料变形率，防漏要求高，设备操作界面为普洛菲斯系列，能快速有效的完成人与机器的信息交换。	Manz	液晶面板清洗线
③ 轨道交通领域			
高铁座椅总成结构件	产品用途：包括高铁座椅转架、底架和靠背等重要组成部分 工艺特点：结构件的安全性较高，在保证强度的同时，需要轻量化设计，底架材质采用Q890和Q960高强度钢板焊接，焊接人员须取得EN 15085焊接资质	上海招达、山东嘉泰、沈阳旭阳	高铁座椅
轨道交通牵引系统结构件	产品用途：用于地铁牵引系统 工艺特点：整个结构件焊接而成，焊接人员须取得EN 15085焊接资质，结构件的安全性、平整度、耐腐蚀性等要求较高，在喷涂前，所有细缝处均需涂抹西卡密封胶，需要做负压测试	江苏经纬	地铁、有轨电车牵引系统
高铁风道系统结构件	产品用途：用于高铁机车空调系统，风道是高铁机车空调系统的重要组成部分 工艺特点：整体采用铆接技术施装，在铆接前板材表面需要涂抹西卡密封胶，风道内部均需要粘贴消音棉，结构件密封性要求较高	金鑫美莱克	高铁风道
高铁空调系统结构件	产品用途：用于高铁空调系统的主机部分 工艺特点：整体采用铆接及焊接技术施装，在铆接前板材表面需要涂抹西卡密封胶，整体需喷涂处理；对结构件抗压性、密封性等方面要求较高	金鑫美莱克	高铁空调系统
④ 医疗器械领域			
医用手术床结构件	产品用途：用于手术室内医用设备，手术床底座的组成部分，医用手术床通过电动调节6个主要动作组，保证床体整体稳定性，格栅件组和易清洁性 工艺特点：结构件采用不锈钢氩弧焊接，表面进行镜砂后电解	迈柯唯、迈瑞医疗	医用手术床
医用吊塔结构件	产品用途：医用吊塔的组成部分，医用吊塔是医疗手术室重要供气医疗设备，主要功能为手术室供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体终端传输，提供电源插孔和悬挂输液装等 工艺特点：结构件采用氩弧焊接而成，所有焊缝需打焊接按口倒焊接槽，对焊接强度要求较高，承载能力要求较高	迈柯唯	医用手术台吊塔
医用灯臂结构件	产品用途：医用手术灯臂的组成部分，手术灯臂主要功能为各种手术场合提供照明需要，对对照明效果、外观、反光性要求高 工艺特点：结构件采用机器人精密焊接，表面需喷刷指纹高光粉末	迈柯唯	医用手术灯臂

（二）产品销售方式和渠道

1、内销

公司的内销均采用直销模式。目前大部分客户均为常年合作的优质客户，公司获得客户的供应商资格认证后会与客户签订框架销售合同，客户向公司发送具体采购订单。公司按照客户订单并获得产品认证后，组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

由于产品均为定制产品，公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认。公司市场部为客户配备客户经理、客服专员负责客户订单的沟通、协调生产、安排交付等事宜。

公司市场部与客户通过商务谈判的方式确认新产品的销售单价。商务谈判中，公司市场部会综合考虑产品所属行业、主要材料成本、研发设计、制造工艺、信用期、技术服务、包装运输以及交货期等因素。公司销售的成熟产品单价调整亦需经公司与客户协商后确定。

2、外销

公司外销模式与内销基本一致，在签订框架协议与下达销售订单环节需明确贸易条款或交付方式。

（三）所需主要原材料

报告期内，受公司产品定制化特点的影响，公司采购的原材料种类较多且较为分散，其中主要采购金属原材料、零配件和外协加工三类，外协加工是外协加工商向发行人提供的外协加工服务；具体如下：

单位：万元、%

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
金属原材料	3,591.69	20.34	2,974.20	19.16	3,587.50	27.23
零配件	7,696.82	43.58	8,109.76	52.25	5,530.97	41.98
外协加工	1,546.12	8.75	1,190.83	7.67	1,142.79	8.67
包装材料	1,023.72	5.80	869.71	5.60	787.28	5.98
五金件	1,402.52	7.94	916.96	5.91	787.43	5.98
其他	2,401.35	13.60	1,459.04	9.40	1,337.97	10.16
合计	17,662.23	100.00	15,520.50	100.00	13,173.94	100.00

（四）行业竞争情况

1、国际竞争格局

精密金属制造服务业作为制造业技术含量较高的新兴行业，起源于欧美、日本等制造业科技水平、管理水平较高的地区。随着全球范围的经济扩张和产业结构调整，全球制造业自20世纪80年代以来加快向亚洲、拉美等新兴市场国家、地区转移，如中国、韩国、中国台湾地区等制造业发展迅猛，规模不断扩大。改革开放以来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，涌现了一批技术水平较高的精密金属制造服务企业。目前我国在全球精密金属制造领域占有重要地位。

2、国内竞争格局

我国精密金属制造企业主要集中于长三角、珠三角及环渤海经济圈等区域经济开放程度较高、市场经济和民营经济较为发达的地区。按照其技术及规模水平分为三个竞争层次：

（1）综合性全球合约制造服务商及其面临的竞争

综合性全球合约制造服务商，如富士康、捷普集团等企业，是集设计、生产、采购、集成组装、物流于一体的垂直型生产企业；其在全球布局，深度参与核心客户的产品设计、零部件生产、产品组装等业务领域；其客户一般为相关行业的全球龙头公司。这类企业通常设立精密金属制造事业部，主要为本企业的终端产品配套服务，供应精密金属结构件，此类企业基本不直接参与精密金属业务的市场竞争。

（2）聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商及其面临的竞争

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商基本以先进的制造企业为核心客户，为其配套提供精密金属结构件。聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商提供的精密金属结构件在“几何形位公差”等方面表现优异。

这一层级代表企业如宝馨科技、华亚智能、常州伟泰、通润装备、科森科技等。其中，部分规模较大企业的客户所属行业分布较广，此类企业对下游个别行业的依赖较小，风险相对较低；部分规模较小企业服务的客户所属行业相对集中，提供的产品和服务相对单一，此类企业对下游单一行业的依赖较大，风险相对较高。

目前，聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商的客户主要集中于汽车、消费电子、半导体、医疗器械、新能源、军工、机电、航空航天等领域。这类企业的客户对供应商有严格、复杂的初期认证，并在之后的合作期间内进行长期持续的过程审核；其对供应商的要求通常包括：完善的质量控制体系、业务管理体系、环境控制体系，较强的研发设计、制造、服务和快速响应等能力，对精密金属结构件的多样化和高精度要求。

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商通常会与客户建立长期稳定的供应链合作关系，参与客户的研发设计，为客户提供定制化服务。同时，客户通常也只选择一家或两家供应商供应特定类型的精密金属结构件，以稳定其供应链合作关系，保证可靠的产品质量和稳定的交货。

这类企业在细分领域积累了一定的经验，具有一定的行业地位和声誉度。其在各专业领域研发设计逐渐深入、与客户合作程度日益加深、自身业务规模不断扩大，业务领域不断延伸，竞争力持续提高，有助于其取得在专业领域内的领先地位，竞争对手会逐渐减少。

综上，聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商凭借其先进制造技术、优质产品质量、及时供货和高效管理等方面的优势，以及与客户建立的长期稳定的供应链合作关系，在其细分领域内取得较强的竞争优势，领域内竞争程度较小。

（3）众多中小金属结构件制造厂商及其面临的竞争

众多中小金属结构件制造厂商以生产大批量普通结构件为主，主要服务当地企业，为客户提供附加值较低、结构简单、品质要求低、精度一般的精密金属结构件。众多中小金属结构件制造厂商提供的精密金属结构件在“几何形位公差”等方面表现较差。

聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商在业务的持续扩张中，为缓解其日渐紧缺的产能，已开始将众多中小结构件制造厂商纳入其供应链体系，为其提供部分简单的精密金属结构件和外协服务。

这类企业技术水平、研发能力和服务质量较低，只需要简单的冲压设备、模具以及简单的焊接就可完成，产品定制化程度较低，竞争力主要来源于成本优势、规模优势，市场竞争比较激烈。

（五）公司在行业中的竞争地位

公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，是国内领先的精密金属制造商之一，并致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套服务商。公司自设立以来，一直专注于精密金属制造领域，随着生产和销售规模的不断扩大，技术积累和企业实力的不断增强，综合竞争力处于行业领先地位。公司凭借在精密金属制造业多年的技术经验积累，为高端领域的客户提供定制化服务。

目前，在核心发展的半导体设备领域，公司的高端精密金属结构件已经应用于半导体晶圆制造设备国际巨头AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商Rudolph Technologies和国内领先制造商中微半导体等的主导产品。在国际市场，公司的产品应用于全球最大的半导体设备制造商AMAT生产的晶圆成膜（PECVD）设备气体输送平台装置、全球晶圆刻蚀设备行业龙头Lam Research生产的半导体晶圆刻蚀控制、检测设备和国际知名的晶圆检测设备制造商Rudolph Technologies生产的晶圆检测设备AWX Series。在国内市场，公司的产品应用于国内领先的半导体设备制造商中微半导体生产的MOCVD设备Prismo A7?。半导体设备作为半导体制造所需的核心装备，对精密金属制品的气密性、喷涂颗粒、装配洁净度、关键料件、防ESD静电等方面技术标准和工艺要求苛刻。2017年，公司获得标准严苛的AMAT喷粉合格供应商认证，成为国内少数取得此项认证的企业之一。

在新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等其他领域，通过与全球领先的光伏逆变器制造商SMA，全球最大的工业与技术服务商通用电气，全球知名电气厂商施耐德，全球知名散热器制造商德默菲，全球生产滚动轴承的领导企业舍弗勒，国内高铁座椅制造商上海坦达，全球领先的医疗设备和系统供应商瑞典洁定集团子公司迈柯唯，中国最大的医疗设备与解决方案供应商迈瑞医疗等国内外一流品牌商建立了稳固的合作关系，公司获得了行业内较高的竞争地位。

公司拥有严格的质量控制体系、完善的行业质量认证标准和严苛的合格供应商认证，满足了包括半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域的高端精密金属结构件的要求，保证了原材料采购、生产加工、装配、销售和售后服务各环节的质量管控。公司已取得通过莱茵TUV认证的资质包括：轨道交通行业的国际铁路行业标准（IRIS）ISO/TS22163:2017认证和铁路设备焊接资质EN 15085-2 CL1；汽车行业的IATF16949:2016认证；金属加工行业熔化焊焊接质量认证EN ISO3834-2；航空航天行业的EN 9100:2018零部件的制造和装配认证证书（相当于航空航天质量管理体系认证AS 9100 D和日本工业标准JISQ 9100:2016）。在半导体设备维修领域，子公司澳科泰克取得针对半导体设备真空阀门维修的ISO9001:2015质量管理体系认证。

公司在生产制造方面积累了精密焊接、表面处理、精密机械加工等多类精密金属核心制造技术。在满足众多下游行业对精密金属制造的要求的同时，公司针对半导体设备领域的精密金属制造技术不断改进和创新，形成了在该领域国际市场独特的竞争优势和核心竞争力。公司还组建了“江苏省企业技术中心”、“江苏省（华亚）焊接自动化工程技术研发中心”和“国家级博士后科研工作站”三大研发机构以及精良的研发团队。公司拥有9项发明专利，51项实用新型专利以及诸多工艺创新。公司生产的2个产品被江苏省科学技术厅认定为江苏省高新技术产品。

五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至2020年12月31日，公司固定资产账面原值为17,369.30万元，账面净值为7,943.26万元，具体如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	成新率
房屋建筑物	6,038.89	2,405.44	3,633.46	60.17
机器设备	9,359.09	5,589.81	3,769.28	40.27
运输工具	934.00	755.77	178.23	19.08
办公及其他设备	1,037.32	675.02	362.29	34.93
合 计	17,369.30	9,426.04	7,943.26	45.73

1、房屋建筑物

截至2020年12月31日，公司房屋建筑物等不动产具体如下：

权利人	证书号码	坐落地址	房屋建筑面积	权利性质	抵押情况
华亚智能	苏（2017）苏州市不动产权第7003273号	相城经济开发区潢川产业园春兴路58号	58,910.72m2	房屋（构筑物）所有权	无

2、主要设备情况

截至2020年12月31日，公司主要生产设备情况如下：

单位：台（或套）、万元

序号	设备名称	数量	账面原值	账面净值	成新率	应用工序	参数
1	激光切割机	6	2,286.25	829.57	36.29%	激光下料	X=3000~4000mm Y=1500~2000mm 板厚T=0.8~12.0mm 精度±0.05mm
2	数控冲床	3	1,088.06	244.38	22.46%	数冲下料	X=3000~2500mm Y=1200~1600mm 板厚T=0.5~4.0mm 精度±0.1mm
3	立式加工中心	13	896.73	205.09	22.87%	立式CNC加工	X=3000~2500mm Y=1200~1600mm Z=510~900mm 精度±0.05mm
4	数控折弯机	17	902.54	322.81	35.77%	折弯	L=4100~1500mm TON=60~225吨 板厚T=0.5~8.0mm（校长计算） 精度±0.1mm
5	五面体加工中心	1	305.30	15.27	5.00%	五面体加工	X=4000mm Y=2000mm Z=510-900mm 精度±0.02~0.05mm
6	自动化旋金立体料库	1	264.79	153.69	58.04%	仓储设备	仓位：342等位 运行精度：1.0~3.0mm
7	光纤激光切管机	1	217.95	148.93	68.33%	管材激光下料	L=4000×16~100mm 精度0.2~0.5mm
8	喷涂流水线	1	164.88